

i9-7960x basierter Build

Beitrag von „DSM2“ vom 20. Juli 2019, 10:17

Moin!

Gegen das Rampage spricht nichts, da es den Aquantia Chipsatz verwendet musst du auch nichts umflashen oder dergleichen damit 10G Lan läuft.

Gebaut habe ich zwar mit diesem Board persönlich nicht aber es wird nicht anders ablaufen als mit anderen X299 ASUS Boards.

RAM:

Das mit dem RAM würde ich an deiner Stelle aber verbessern, entweder oder und nicht dieses Gemisch.

Quad Kit ala 16GB pro Modul oder gleich das volle Packet.

2666MHz sind völlig ausreichend und alles über 3200 macht eigentlich eh keinen Sinn und ist verschenktes Geld.

Kühlung:

Wenn du das Case nicht tauschen möchtest, damit wirklich alles im Gehäuse verbaut ist und nichts außen,

dann solltest du den zweiten definitiv gegen einen 480 (45/60)/560mm austauschen, natürlich je nachdem was du vorhast. (Overclocking)

7960X:

Grundsätzlich hätte ich eher an deiner Stelle auf die neuen Cascade Lake X CPUs gewartet alleine schon wegen dem Preisverfall...

Was du bedenken musst ist das du die Garantie durch den Delid verlierst, wenn du noch keinerlei Erfahrung damit hast,

dann kann ich dir eigentlich empfehlen die CPU delidden zu lassen da es a) günstiger kommt b) definitiv alles korrekt gemacht wird.

Sowas biete ich gegen Entgelt übrigens auch an, soll jetzt aber eigentlich keine Eigenwerbung sein in diesem Post.

Es gibt zwei Möglichkeiten:

1) Entweder man nimmt den IHS ab und entfernt die "Wärmeleitpaste", Isoliert die SMDs, trägt Liquid Metal auf und montiert dann den IHS mit hitzebeständigem Silikon wieder drauf.

2) IHS runter, SMDs isolieren, Liquid Metal drauf und montiert die CPU anschließend mit dem Skylake-X Direct-Die Frame auf das Board, dafür muss dann der Original Befestigungsrahmen runter.

Der Skylake-X Direct-Die Frame brauchst du nicht zum Höhenausgleich, den dieser gleicht gar keine Höhe aus,

sondern ist dafür gemacht damit man den CPU Block direkt auf die DIE Montiert und nicht wie üblich auf den IHS, braucht aber womöglich andere Befestigungsschrauben für den CPU Block selbst da sich die Höhe verändert hat und somit womöglich der Block nicht auf dem DIE aufliegt was wiederum keine richtige Kühlung ermöglicht.

Die Lösung mit dem Frame ermöglicht es noch einmal ein paar grad Kühler unterwegs zu sein als es schon mit Liquid Metal der Fall ist wenn IHS wieder montiert wird.

Man kann durchaus schauen was die CPU hergibt, bevor man einen Delid macht aber grundsätzlich wirst du nicht allzuviel rauskriegen, da die Temperatur das Problem ist!